



证券代码：300567

证券简称：精测电子

编号：2026-009

武汉精测电子集团股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他__电话会议__
参与单位名称及人员姓名	华西证券、长江证券、国联民生、兴业证券、广发证券、中泰证券、银华基金、东方基金、南方基金、博时基金、华源证券、浙商证券、申万菱信、平安基金、长城基金、华泰证券、中邮证券、国信证券、招商证券、天风证券、长安基金、华福证券、山西证券、东方证券、东吴证券、招银理财、浦银基金、西部利得基金、摩根士丹利、交银施罗德基金、西部证券、开源证券、易方达基金、建信基金、泓铭资本、长盛基金、麦格理资本、华商基金、民生加银基金、国金基金、太平洋证券、中信期货、中国银河证券、光大永明资管、上海云门投资、东海证券、富安达基金、盛博香港、摩根大通、鹏华基金、群益证券、农银汇理基金、瑞兆资管、海富通基金、天津远望资管、深圳红筹投资、深圳市尚诚资管、玄卜投资、观富资管、浙江韶夏资管、上海景富资管、诚通证券、鑫巢资管、嘉信私募基金、路博迈基金、立格资本、中天国富证券、凯基证券、北京煜诚私募、瑞银资产、盛博香港、长城财富资管、野村东方国际证券、前海再保险、国元证券、中再资管、爱建证券、名禹资管、华宝基金、泰山财险、宏恩资管、天治基金、上海禾升投资、丰海资管、泾谷私募、利幄私募基金、七叶树资产、杭州深沃投资、上海明河投资、北京禾永投资、汇泉基金、芯湃资本、星展银行(香港)、睿远基金、富国基金、淳厚基金、宝隼资管、柏骏资管、鹏山资管、沃金投资、江信基金、



	原泽私募基金、诺安基金等 200 余家机构（排名不分先后）
时间	2026 年 10 月 28 日
地点	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2 号公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、显示及新能源事业群总经理：刘荣华先生 董事、副总经理、董事会秘书：刘炳华先生 财务负责人：游丽娟女士 上海精测投融资总监：李国先生 证券事务代表：程敏女士
投资者关系活动主要内容介绍	Q1：公司 2026 年第三季度整体情况介绍。 A：2026 年第三季度，公司实现营业收入 104,028.22 万元，较上年同比增长 16.93%；实现归属上市公司股东的净利润 499.43 万元，较上年同比减少 93.10%；若剔除报告期内公司股权激励确认股份支付费用的影响，报告期内公司实现归属上市公司股东的净利润 11,572.09 万元，较上年同比增加 59.78%。2026 年 1-9 月公司实现营业收入 285,215.87 万元，较上年同比增长 25.61%；实现归属上市公司股东的净利润 8,002.92 万元，较上年同比减少 20.04%；若剔除公司股权激励确认股份支付费用的影响，2026 年 1-9 月公司实现归属上市公司股东的净利润 19,075.58 万元，较上年同比增加 90.59%。 Q2：公司在手订单情况如何？ A：截至《2026 年第三季度报告》披露日，公司取得在手订单金额总计约 54.50 亿元，其中半导体领域在手订单约 36.57 亿元、显示领域在手订单约 11.81 亿元、新能源领域在手订单约 6.12 亿元，公司半导体业务已成为公司经营业绩的重要支撑。 Q3：2026 年三季度公司在半导体领域情况介绍。 A：2026 年三季度，公司半导体领域订单、营收均主要来源于前道量检测领域，前道量检测领域订单、营收占半导体领域整体九成以上，后道检测等领域处于市场导入深化阶段，占公司半导体领域营收和订单的比例较低。截至本报告披露日，公司半导



体领域在手订单约 36.57 亿元，相较于去年同期增长 105.34%；公司半导体领域订单实现快速增长，但受现有生产场地空间、产线承载能力约束，产能供给阶段性趋紧，导致部分订单交付周期有所延长；受交付节奏影响，当期收入确认增速暂未与订单增速同步。随着四季度新建厂房逐步建成并投产，产能瓶颈有望得到有效缓解，后续订单交付及收入确认节奏将逐步改善，支撑半导体业务收入稳步释放。报告期内，公司半导体领域实现营业收入 31,025.64 万元，较上年同期增长 16.15%，归母净利润-1,464.07 万元；若剔除报告期内公司股权激励确认股份支付费用的影响，归母净利润约为 1,222.30 万元（公司控股子公司上海精积微主要聚焦明暗场晶圆缺陷检测方向，报告期内进一步加大相关研发投入力度，致使当期经营亏损同比有所扩大；同时公司对其持股比例较去年同期有所提升，综合影响下，公司归母净利润较上年同期减少约 4,100 万元）。

Q4：2026 年三季度公司在显示和新能源领域情况介绍。

A：报告期内，全球显示市场延续结构性特征，整体呈现“底部震荡、结构性分化”的格局：传统消费终端需求修复力度有限，大尺寸 LCD 价格季末企稳，IT 面板需求疲软，中小尺寸手机 OLED 面临量价压力；车载显示、高端中尺寸 OLED 等赛道保持较快增长。报告期内，公司显示板块实现营业收入 54,472.38 万元，较上年同期减少 3.55%；归母净利润-693.51 万元；若剔除报告期内公司股权激励确认股份支付费用的影响，归母净利润约为 7,442.17 万元（报告期内，公司继续保持在显示领域的高研发投入，公司显示检测领域研发投入 12,370.37 万元，较上年同期增长 66.78%）。报告期内，公司在新能源领域持续优化产品结构、深化生产精益管控，实现营业收入 17,745.41 万元，较上年同期增长 441.58%，归母净利润 2,955.97 万元；若剔除报告期内公司股权激励确认股份支付费用的影响，归母净利润约为 3,066.44 万元。



Q5：公司在明场光学缺陷检测设备进展情况。

A：公司明场光学缺陷检测设备产品已完成 28nm 制程产线的验收和 14nm 制程产线的重复交付，伴随着公司 14nm 制程订单的再一次交付，产品迭代优化，设备整机成熟度持续提升，供应链核心零部件实现进一步完善与稳定，上述进展进一步巩固了公司在明场光学缺陷检测设备领域的竞争优势，有利于带动国内该类装备的技术迭代与产业发展。

Q6：公司 HBM 相关前道量检测设备类型和业务介绍。

A：在 HBM 先进封装前道量检测领域，公司现有膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备、明场光学缺陷检测设备为核心产品已全部导入先进封装产线。公司先进封装业务主要跟随客户的开发节奏同步推进，现阶段，公司面向 2.5D 和 3D 先进封装的设备主要有 TSV 刻蚀后高深宽比结构测量、HBM 硅片形貌测量、混合键合表面粗糙度测量、TSV 填铜后 CMP 集成式铜凹陷量测等设备，多款设备已完成客户交付，实现落地应用。

Q7：公司在 TGV 领域的进展和布局介绍。

A：公司围绕玻璃基板及面板级先进封装已形成专项产品布局，相关设备已累计交付多台。其中 TGV 相关方案已覆盖孔径、位置度、上下表面孔径、腰孔、真圆度、锥度及孔内结构等关键量检测项目，目前已具备相关关键参数亚微米至微米级量测能力，并已与多家客户完成样品打样及检测验证。公司正结合不同客户的材料、孔型及工艺需求，持续推进设备优化和产品定型。后续，公司将结合下游客户工艺成熟度和产线建设节奏，持续推进 TGV 相关设备的工艺验证、产品定型及量产适配，重点提升大尺寸面板、高精度量测、多层结构检测及量产效率等能力，积极把握玻璃基板及面板级先进封装国产化发展机遇。

接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、



精测电子投资者关系活动记录表（2026 年度）

	准确、完整、及时、公平。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 10 月 28 日